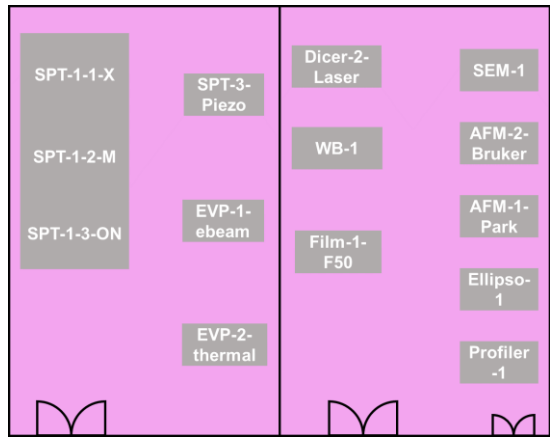




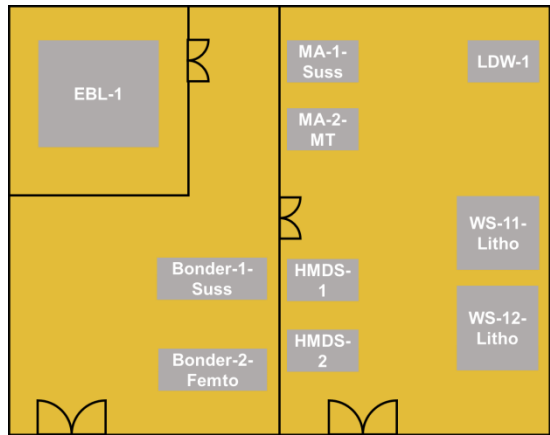
洁净等级	样品与材料限制
I	不允许任何金属或经历过金属工艺的产品进入
II	允许 Ti、Al、Ni、Cr、Ta、W 等指定金属；禁止 Au、Pt、Pd、Ag、Sn、Sb、Bi 等高污染风险金属
III	允许大部分金属，包括 Au、Pt、Pd、Ag、Sn、Sb、Bi 等；仍需排除汞、放射性、易挥发或设备不兼容材料

PVD 区与量测区



设备简称	设备名称	洁净等级	设备简称	设备名称	洁净等级
SPT-1-1-M	金属沉积磁控溅射	III	WB-1	半自动引线键合机	III
SPT-1-2-ON	氧化物/氮化物沉积磁控溅射	II	Film-1-F50	膜厚仪	I/II/III
SPT-1-3-X	新材料沉积磁控溅射	II	SEM-1	扫描电子显微镜	I/II/III
SPT-3-Piezo	压电材料沉积机	II	AFM-2-Bruker	原子力显微镜	I/II/III
EVP-1-cbeam	双腔电子束蒸发系统	III	AFM-1-Park	原子力显微镜	I/II/III
EVP-2-cbeam	双腔电子束蒸发系统	II	Ellipso-1	椭偏仪	I/II/III
EVP-3-thermal	高真空热蒸发系统	III	Profiler-1	台阶仪	I/II/III
Dicer-2-Laser	激光划片机	I/II/III			

黄光区



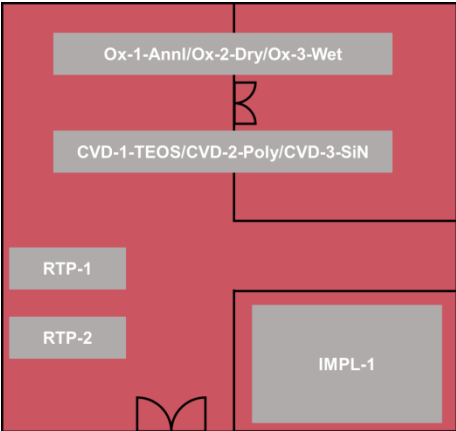
设备简称	设备名称	洁净等级	设备简称	设备名称	洁净等级
EBL-1	EBL 电子束曝光机	I/II/III	MA-1-Suss	紫外曝光机 1	I/II/III
Bonder-1-Suss	晶圆键合机	II/III	MA-2-MT	紫外曝光机 2	I/II/III
Bonder-2-Femto	高精度贴片机	III	LDW-1	激光直写曝光机	I/II/III
WS-11-Litho	半自动光刻工艺台 1	I/II/III	HMDS-1	HMDS 烘箱	I
WS-12-Litho	半自动光刻工艺台 2	I/II/III	HMDS-2	HMDS 烘箱	III

有机湿法和无机湿法区



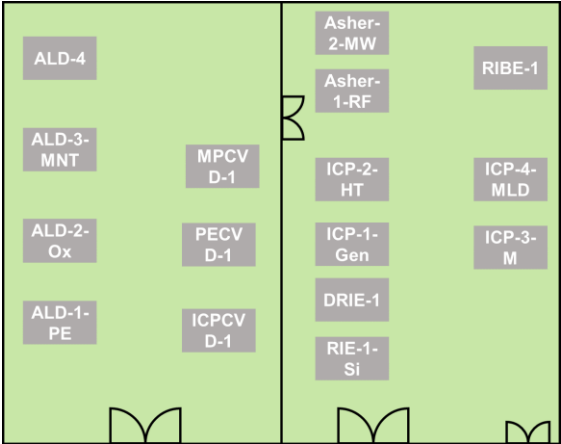
设备简称	设备名称	洁净等级	设备简称	设备名称	洁净等级
Dicer-1	双轴划片机	I/II/III	WS-6-Acid	后道-自定义酸刻蚀工艺台 1	I
CMP-1	化学机械抛光系统	II	WS-7-Acid	后道-自定义酸刻蚀工艺台 2	II/III
WS-1-Etch-Al	前道-槽式酸刻蚀工艺台-Al	II	WS-8-Org	自定义有机工艺台 1	I/II/III
WS-1-Etch-Cr	前道-槽式酸刻蚀工艺台-Cr	II	WS-9-Org1/2	自定义有机工艺台 2	I
WS-1-Etch-SiN	前道-槽式酸刻蚀工艺台-SiN	I	WS-9-Org3/4	自定义有机工艺台 2	II
WS-1-Etch-BOE	前道-槽式酸刻蚀工艺台-BOE	II	WS-10-Org1/2	槽式有机工艺台	I
WS-2-Clean-SPM	前道-槽式晶圆清洗-SPM	I	WS-10-Org3/4	槽式有机工艺台	I
WS-2-Clean-DHF	前道-槽式晶圆清洗-DHF	I	SRD-1	甩干机	II
WS-2-Clean-SC1	前道-槽式晶圆清洗-SC1	II→I	SRD-2	甩干机	I
WS-2-Clean-SC2	前道-槽式晶圆清洗-SC2	II→I	SRD-3	甩干机	III
WS-3-HF	后道-自定义 HF 刻蚀工艺台	I/II/III	SRD-4	甩干机	I
WS-4-Base	后道-自定义碱刻蚀工艺台 1	I	SRD-5	甩干机	I
WS-5-Base	后道-自定义碱刻蚀工艺台 2	II/III			

注入与热处理区



设备简称	设备名称	洁净等级	设备简称	设备名称	洁净等级
IMPL-1	离子注入机	I/II/III	RTP-2	RTP 真空快速退火炉	III
Ox-1-Annl Ox-2-Dry Ox-3-Wet	管式炉-氧化退火炉	I	CVD-1-TEOS CVD-2-Poly CVD-3-SiN	管式炉-卧式 LPCVD	I
RTP-1	RTP 真空快速退火炉	II			

化学镀膜区和干刻区



设备简称	设备名称	洁净等级	设备简称	设备名称	洁净等级
ALD-1-PE	等离子体原子层沉积	II	ICP-2-HT	高温刻蚀机	III
ALD-2-Ox	热型原子层沉积	II	DRIE-1	深硅刻蚀机	I
ALD-3-MNT	热型原子层沉积	III	RIE-1-Si	硅相关介质刻蚀机	I
ALD-4	原子层沉积	/	ICP-3-M	通用金属刻蚀机	II
PECVD-1	PECVD	I	ICP-4-MLD	低损伤金属刻蚀机	II
ICPCVD-1	ICPCVD	III	RIBE-1	RIBE 离子束刻蚀机	III
MPCVD-1	MPCVD	II	Asher-1-RF	等离子去胶机	III
ICP-1-Gen	通用介质刻蚀机	II	Asher-2-MW	等离子去胶机	II